



산업통상자원부



2024(하) 반도체특성화대학원지원(성균관대학교) 반도체 산학 교류회

(Semiconductor Industry–Academic Exchange Conference)

주 관: 반도체특성화대학원사업단(산업통상자원부), 성균관대학교 반도체융합공학과

후 원: 산업통상자원부, 성균관대학교

부산 BEXCO 110호

2024년 10월 17일(목), 14:00~18:00

Chair: 한재현, 성균관대학교 (Jae Hyun Han, Sungkyunkwan Univ.)

14:00	Opening remarks	한재현, 성균관대학교 <i>(Jae Hyun Han, Sungkyunkwan Univ.)</i>
14:10	[Keynote Lecture] 반도체 패키징 소재 기술 동향 <i>(Semiconductor packaging material trend)</i>	고영관, 삼성전자 <i>(Young Gwan Ko, Samsung Electronics)</i>
14:50	[Keynote Lecture] Nand flash 제품의 고종횡비 패턴링을 위한 새로운 도전과 솔루션 <i>(New challenges and solutions for high aspect ratio patterning in Nand flash devices)</i>	민재호, 삼성전자 <i>(Jae Ho Min, Samsung Electronics)</i>
15:30	[Keynote Lecture] 메모리 반도체 기술의 과제 <i>(Memory technology challenges)</i>	김백만, SK하이닉스 <i>(Baek-Mann Kim, SK Hynix)</i>
16:10	[Keynote Lecture] 차세대 반도체 제품용 박막기술 <i>(Thin film technologies for next generation devices)</i>	이공수, 삼성전자 <i>(Kong-soo Lee, Samsung Electronics)</i>
16:50	[Keynote Lecture] 대형 인공지능 모델 경량화 및 반복 인공지능 모델 가속화 동향 <i>(Trends in lightening large AI models and accelerating iterative AI models)</i>	전일용, 성균관대학교 <i>(Il Yong Chun, Sungkyunkwan Univ.)</i>
17:30	Wrap-up	김원식, 성균관대학교 <i>(Won Sik Kim, Sungkyunkwan Univ.)</i>

Keynote Speaker



고영관, 삼성전자
Young Gwan Ko, Samsung Electronics
2002 서울대 화학공학 박사
2015 삼성전기 FOPLP TF장 상무
현 재 삼성전자 TSP소재기술팀장 상무



민재호, 삼성전자
Jae Ho Min, Samsung Electronics
2006 서울대 화학공학 박사
2006 삼성전자 반도체연구소
공정개발팀 일사
현 재 삼성전자 플래시 공정개발
담당임원



김백만, SK하이닉스
Baek-Mann Kim, SK Hynix
2001 서울대 화학공학 박사
현 재 SK하이닉스 미래기술연구원
Fellow



이공수, 삼성전자
Kong-soo Lee, Samsung Electronics
1998 한양대 재료공학 석사
2012 성균관대 반도체디스플레이공학
박사
현 재 삼성전자 차세대공정개발2팀
연구원



전일용, 성균관대학교
Il Yong Chun, Sungkyunkwan Univ.
2009 퍼듀대 전자전기컴퓨터공학 박사
2017 미시간대 전기공학및컴퓨터과학과
Fellow
2019 하와이대 전자전기컴퓨터공학과
조교수
현 재 성균관대 전자전기공학부 조교수

Organizer/Chair



한재현, 성균관대학교
Jae Hyun Han, Sungkyunkwan Univ.
1996 서울대 화학공학 박사
2004 삼성전자 수석(DRAM, 공정개발,
설비개발)
현 재 성균관대 반도체융합공학과
산학교수